

证券代码：300054

证券简称：鼎龙股份

湖北鼎龙控股股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20221125

投资者关系 活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他：鼎龙股份-昌红科技晶圆载具业务交流电话会议 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称 及人员姓名	圆信永丰基金：汪萍、肖世源；富国基金：刘兴旺、王佳晨；招商基金：张馨洋、张林；博时基金：吴渭、肖瑞瑾；南方基金：谢巍；景顺长城：詹成、董晗；摩根士丹利华鑫基金：李子洋、潘海洋、赵伟捷；东吴基金：毛可君、吴佳韵；高毅资产：王骊鹏；常春藤投资：刘涛；前海人寿：王安艺；中银基金：王方舟等 50 名投资者及证券人员。
时间	2022 年 11 月 23 日下午 15:00~16:00
地点	电话会议
上市公司接待 人员姓名	鼎龙股份董事会秘书：杨平彩； 昌红科技董事会秘书：刘力。
投资者 关系活动 主要内容 介绍	<p>鼎龙股份联合深圳市昌红科技股份有限公司（简称“昌红科技”，代码“300151”）开展晶圆载具业务专场交流</p> <p>一、鼎龙股份基本情况</p> <p>鼎龙股份是国内领先的关键大赛道领域中各类核心“卡脖子”进口替代类创新材料的平台型公司，目前重点聚焦：半导体创新材料领域（半导体 CMP 制程工艺材料、半导体显示材料、半导体先进封装材料三个细分板块）。</p> <p>第一个领域是半导体制程工艺材料领域，布局了集成电路制程 CMP 环节的四款核心材料，包括 CMP 抛光垫、CMP 抛光液和清洗液，以及联合开发的钻石碟产品。目前 CMP 环节的这四款材料在国内整体的自主化率较低，多以海外进口产品为主，整体自主化替代的市场空间较大。目前公司是国内唯一一家全面掌握抛光垫全流程核心研发和制造技术的 CMP 抛光垫的国产供应商，也是全球范围内唯一的一家在 CMP 环节的 4 款核心材料都有产品线布局的供应商。</p> <p>第二个领域是半导体显示材料领域，目前已有 YPI、PSPI 两款材料在下游开始形成销售规模，今年销售收入预期为千万级别。这两款产品的研发难度高，验证门槛高，验证的周期长。目前这两款产品在国内没有国产的供应商，主要为日本友商占据绝大部分市场份额，下游国内核心面板客户基本上把公司相关产品作为一供的方向进行培养和替代。</p> <p>第三个领域是半导体先进封装材料领域，技术门槛也非常高，很多核心</p>

材料以海外进口为主。这一领域的进展还是比较快的，其中有两款产品是边做研发，边在搭建中试线，争取在今年年底或明年年初开始取得销售收入。

从去年开始，鼎龙半导体材料业务的收入占比逐步提升，从去年 13% 左右提升到了今年前三季度的 20%。未来两三年，半导体的材料收入占比会越来越高。虽然目前整个半导体材料业务中只有 CMP 抛光垫一款材料产品处于盈利状态，但是明年 CMP 抛光液、清洗液，以及 YPI、PSPI 等几款柔性显示材料产品预计将进入到快速放量阶段，有可能开始实现规模的盈利。所以我们预期，未来这两三年鼎龙在半导体材料领域将进入到发展的快车道。

二、昌红科技基本情况

昌红科技设立于 2001 年，于 2010 年在创业板上市。在公司发展的前十年，以日资企业为主，公司主要客户包括柯尼卡美能达、理光、佳能等日系企业。上市后，OA 办公自动化领域呈现两大趋势：一是下游的整机厂搬迁至东南亚，所以公司也随之将生产线布局至越南和菲律宾。二是 OA 办公自动化市场容量没有较大空间，因此公司在持续发展的过程中，迫切需要有新的行业、新的领域去拓展。所以在 2010 年开始，公司布局了医疗板块。在医疗领域，公司起步并不快，主要原因在于公司以技术见长，进入医疗领域之初即对标的医疗世界巨头，包括罗氏、赛默飞等客户。公司希望以成熟、精湛的技术去征服客户，而不是在中低端的耗材市场去拼价格。

公司在 2015 年和罗氏已经有了初步的接洽，到 2020 年海外疫情爆发，罗氏的设备在海外的检测量剧增，而相关耗材的供应链出现紧缺。罗氏以尝试的态度把一些订单交给了深圳柏明胜（昌红科技全资子公司）。在海外供应链里面，从模具的开发、自动线的研发到整个配套的生产，通常需要两到三年的时间。而公司在 2020 年短短半年时间即交付了让罗氏满意的产品。以此为契机，公司成功进入罗氏供应链。2021 年，上海进博会，罗氏跟深圳柏明胜签订了全球战略合作协议，在 2022 年 11 月初的上海进博会，罗氏又颁给公司商业连续性奖，表彰公司在整个疫情三年期间为罗氏诊断的业务保持连续的供应市场。

2022 年 3 月份公司与鼎龙股份交流，了解到各大晶圆厂商、FAB 厂现有的晶圆载具供应相对处于紧缺状态。晶圆载具 80%-90% 的市场份额被美国的英特格、日本信越等公司占据。在此背景之下，昌红科技和鼎龙股份合作成立了鼎龙蔚柏这家合资公司，共同开拓晶圆载具市场。

三、提问与交流

1、鼎龙股份在 CMP 抛光液核心原材料研磨粒子的布局情况如何？

杨平彩回复：CMP 抛光液核心原材料主要是研磨粒子，目前国内基本上是以日系和美系的原材料进口为主。过往研磨粒子是没有办法国产化的，因为这一块的技术难度还是非常高的。公司从抛光液上游核心原材料研磨粒子的开发开始，目前已经实现了超纯硅溶胶，水玻璃硅溶胶、氧化铝三类研磨粒子的自主制备，氧化铈研磨粒子的开发也在按计划推进中。在产能建设方面，武汉本部有 5000 吨的年产规模 CMP 抛光液产线，仙桃工业园年产 2 万吨 CMP 抛光液扩产项目及研磨粒子配套扩产项目等的产能建设正加紧进行中，力争明年夏季建设完成，为后期持续稳定放量奠定基础。

2、鼎龙股份未来两年的半导体材料的营收占比有怎样的一个规划和变化呢？

杨平彩回复：公司半导体材料收入占公司总营业收入比例已经由 21 年年底的 13% 提升至 2022 年前三季度的 20%。公司 CMP 抛光垫业务稳健向好，此外，公司多款 CMP 抛光液、清洗液产品以及柔显材料 YPI、PSPI 产品均形成批量规模化销售，公司半导体材料已经全面进入快速推进阶段。未来两到三年的时间，公司半导体材料的收入水平有望超过目前打印复印耗材的收入体量。

3、鼎龙股份抛光垫三期进展如何，抛光垫业务大概的展望怎样？

杨平彩回复：公司武汉本部一二期的 CMP 抛光垫年产规模合计是 30 万片，另外，公司在潜江工业园补充了 20 万片抛光垫新品及 30 万片核心配套原材料的扩产建设。截至目前，潜江三期项目抛光垫新品产线已建设完工处于试生产阶段，并已经送样给主流客户测试，目前客户反馈测试效果良好。市场开拓方面，考虑到国内国产化需求及海外市场推广等因素，公司提前进行未来产能储备，保证供货安全及稳定。

4、除了晶圆载具，另外在半导体 CMP 的过程当中的研磨液的存储罐、过滤器、支架、接头、管路阀门等产品有没有布局？

刘力回复：昌红科技以精密模具设计制造和下游高分子塑胶产品制造见长。在半导体领域，只要是和注塑、塑料相关的领域都是公司未来潜在的市场空间。公司以晶圆载具为一个突破口，以此在半导体领域建立起品牌和形象，未来有可能逐渐布局半导体制程相关塑胶件。

5、（1）晶圆载具目前还是美国或日本为主，晶圆载具目前了解供应比较紧张，晶圆载具的市场空间和格局以及公司现在的目标市场，目前公司是做 12 英寸还是 6 或 8 英寸的晶圆载具？（2）像过滤/塑料管路在各类半导体设备里都用得到特别多，今年由于全球都在开晶圆厂，导致过滤/塑料管路都特别紧缺，公司目前有没有开始做产品设计和验证，是有初步想法还是已经开始验证了？

刘力回复：（1）：晶圆载具紧缺源于两方面。一是扩产需求，晶圆载具相对晶圆而言单品价格不高，但对晶圆量产的良率影响重大。载具供应商一旦进入晶圆厂，跟客户粘性将特别强、很难替换掉。载具的难度在于精度要求很高，这对模具设计和注塑工艺要求高。二是生产周期和验证周期的难度，鼎龙蔚柏目前开发的最大模具重达 15 吨，精度要求极高。在客户验证过程中，从 T0 开始需要不断同客户反复交流，速度也很关键。昌红以技术见长，做的是最难的 12 英寸晶圆载具。

（2）半导体行业的塑料产品对中国企业来说面临困难，其中重要的一个是就原材料的困难，包括半导体湿法设备里的大量塑料管路。想进入这个行业，首先要解决原材料方面的掣肘。公司与中石化探讨过，但能否接受得了半导体行业的客户认证还需要一个周期。所以过滤/塑料管路等产品是公司未来潜在的一个发展方向，目前处于初步设想阶段。

6、（1）载具方面哪些下游客户在做一些送样和测试？（2）上虞工厂目前载

	<p>具产线的情况如何？</p> <p>刘力回复：（1）：目前载具目标客户包括多家国内主流的半导体厂商。短期而言，公司不会给很多客户供应，只会选择一两家完成送样测试。</p> <p>（2）目前上虞工厂载具产线能看到初步试模的样品，主要设备已就位。另外会延误周期的可能点是相关体系的认证，因此真正要取得订单还需要一段时间。</p> <p>7、国内晶圆载具厂商还是以简单的晶圆包装盒为主，信越也有晶圆运输盒，我们对标的还是以他高难度的FOUP包括FOSB这样的产品为主是吗？</p> <p>刘力回复：国内同行，模具基本不是自行设计研发生产，配合存在难度，且国内同行提供的产品大多用于蓝宝石等产品的装载，在高端的碳化硅、半导体晶圆领域都鲜有应用，鼎龙蔚柏现在从高端到低端，先做最难的产品。</p>
附件清单	无
日期	2022年11月23日